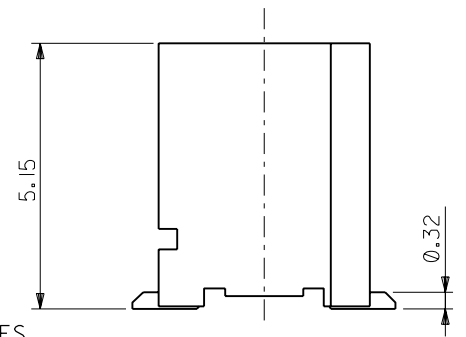
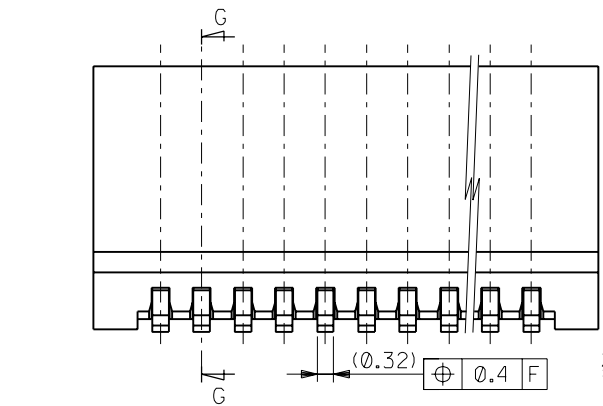
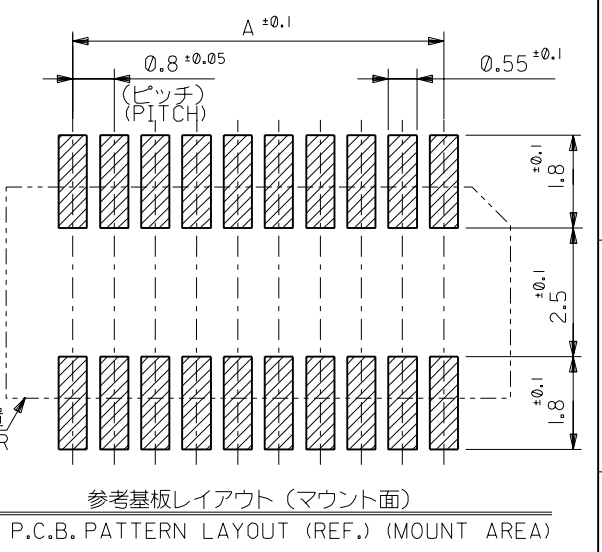
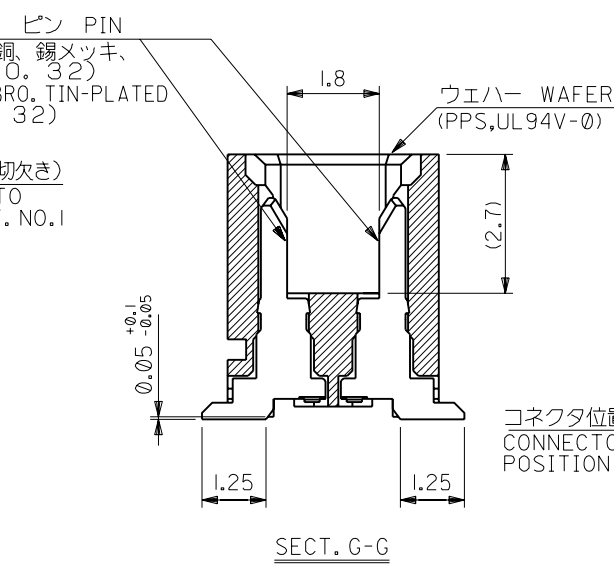
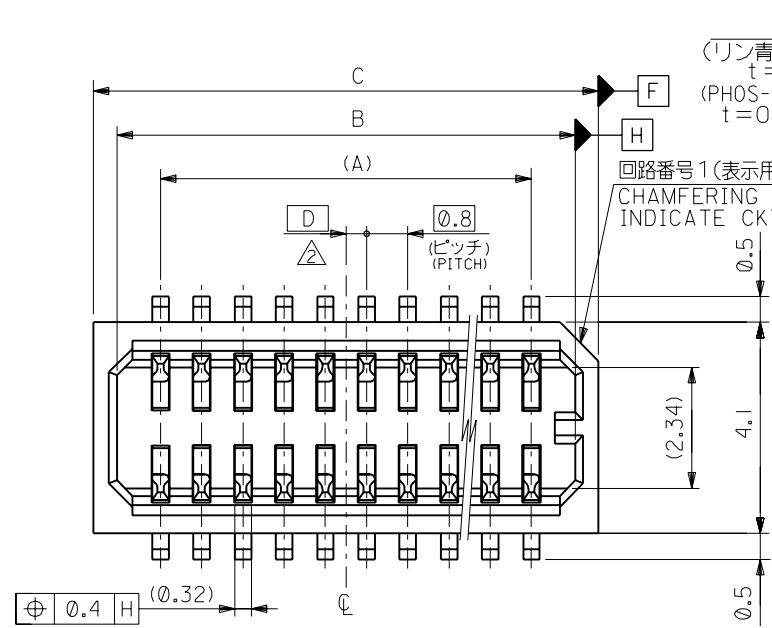


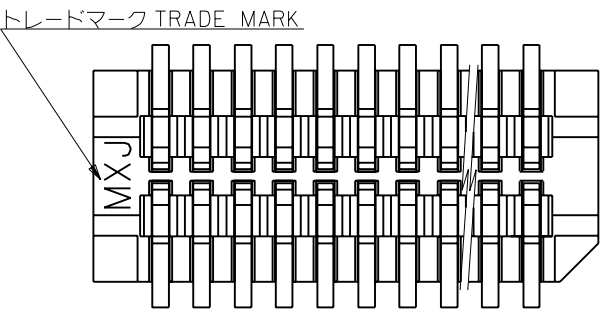
DWG. NO. SD-53364-**-27



注記 NOTES

1. 嵌合相手: 52465, 52588 シリーズ
MATES WITH: 52465, 52588 SERIES
- △ ウェハーの ϕ から隣接するピンの ϕ 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM ϕ OF WAFER TO ϕ OF ADJACENT PINS.

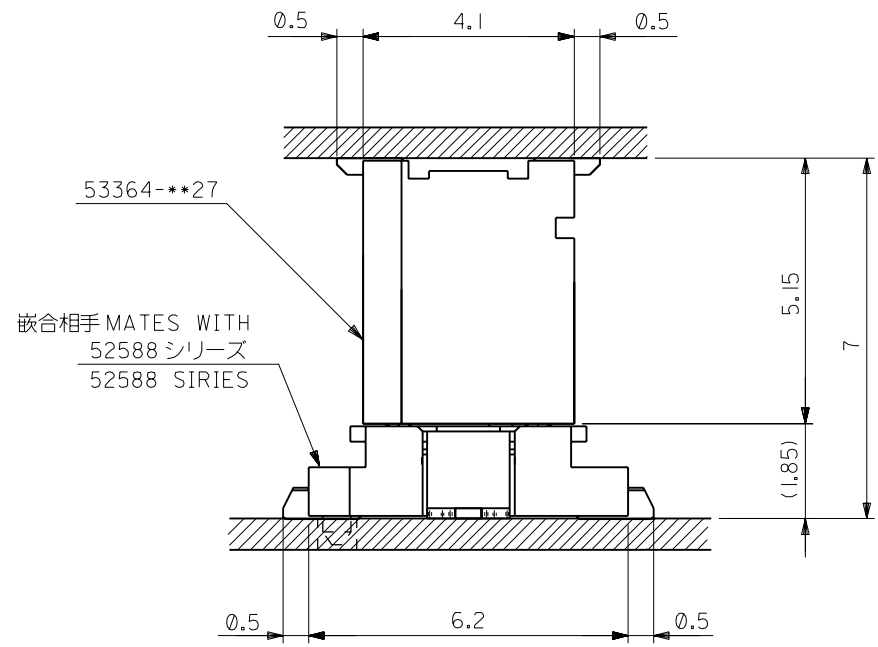
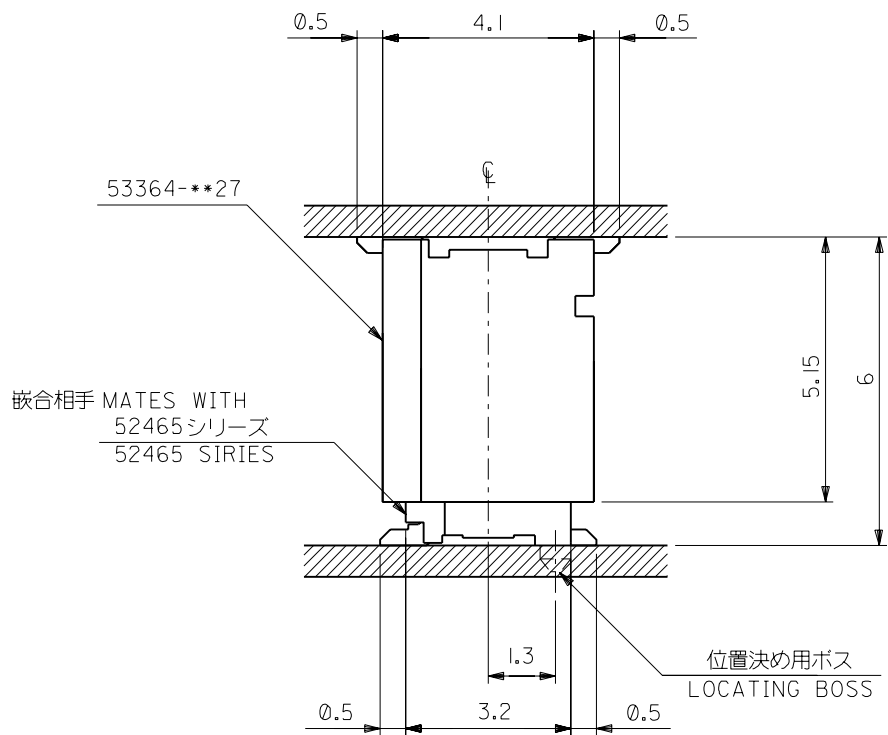
0.4	17.8	16.9	15.2	53364-4027	40
0.8	17.0	16.1	14.4	53364-3827	38
0.4	16.2	15.3	13.6	53364-3627	36
0.8	15.4	14.5	12.8	53364-3427	34
0.4	14.6	13.7	12.0	53364-3227	32
0.8	13.8	12.9	11.2	53364-3027	30
0.4	13.0	12.1	10.4	53364-2827	28
0.8	12.2	11.3	9.6	53364-2627	26
0.4	11.4	10.5	8.8	53364-2427	24
0.8	10.6	9.7	8.0	53364-2227	22
0.4	9.8	8.9	7.2	53364-2027	20
0.8	9.0	8.1	6.4	53364-1827	18
0.4	8.2	7.3	5.6	53364-1627	16
0.8	7.4	6.5	4.8	53364-1427	14
0.4	6.6	5.7	4.0	53364-1227	12
0.8	5.8	4.9	3.2	53364-1027	10
D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.



材料 MATERIAL		図中参照 SEE DRAWING		MATERIAL		MATERIAL	
仕上げ FINISH		—#—		MATERIAL		MATERIAL	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		MATERIAL		MATERIAL	
被覆外径 INS. RANGE		—#—		MATERIAL		MATERIAL	
DRAWN BY '95/7/17		CHK'D BY '95/7/17		DRAWN BY '95/7/17		CHK'D BY '95/7/17	
M.NAKAMURA		Y.M.H.HIRAMOTO		M.NAKAMURA		Y.M.H.HIRAMOTO	
APP'D BY '95/7/17		日付 DATE		APP'D BY '95/7/17		日付 DATE	
M.FUKUSHIMA		—#—		M.FUKUSHIMA		—#—	
DR. CHK.		DATE		DR. CHK.		DATE	
REVISION RECORD		REVISION RECORD		REVISION RECORD		REVISION RECORD	
0 新規作成 RELEASED (JC60025)		M.N.H.H.		0 新規作成 RELEASED (JC60025)		M.N.H.H.	
1 一般公差 GENERAL TOLERANCES		—#—		1 一般公差 GENERAL TOLERANCES		—#—	
30 以上 OVER		+0.3		30 以上 OVER		+0.3	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER		+0.25		10 以上 OVER 30 未満 UNDER		+0.25	
10 未満 UNDER		+0.2		10 未満 UNDER		+0.2	

A53364.5/2

DWG. NO.
SD-53364-**-27



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

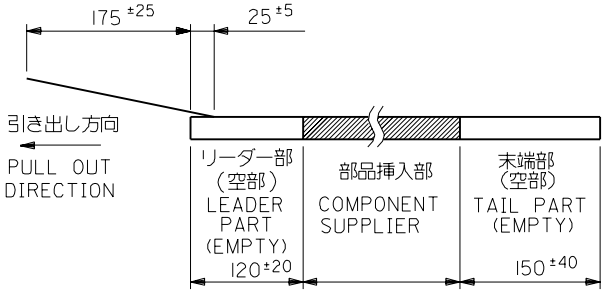
角度 ANGLE 30° 以上 OVER +0.3 10° 以上 OVER 30° UNDER +0.25 未満 UNDER +0.2 10° UNDER		新規作成 RELEASED (JC60025) M.N.H.H. 記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD DR. CHK. DATE		材料 MATERIAL SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2 仕上げ FINISH —#— 適用電線範囲 WIRE RANGE —#— 被覆外径 INS. RANGE —#— DRAWN BY '95/7/17 M.NAKAMURA APP'D BY '95/7/17 M.FUKUSHIMA CHK'D BY '95/7/17 Y.M.H.HIRAMOTO 尺度 SCALE —#—		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y ST. SMT (WITHOUT BOSS) DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53364-**-27 0	
---	--	---	--	---	--	--	--

注記 NOTES

1. 梱包数量：1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE リーダー部 LEADER PART
トップテープ TOP TAPE 未接着部 NON-BONDED PART



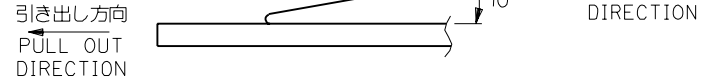
3. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)

0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE

0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



4. 材料

キャリアテープ：ポリプロピレン (PP) CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
トップテープ：PET, PE, PEF TOP TAPE:PET,PE,PEF
リール：ポリスチレン (PS) REEL:POLYSTYREN(PS)
<リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

MATERIAL

16	17.5	9.3	7.5	53364-1891	18
		6.9	5.1	53364-1291	12
		6.1	4.3	53364-1091	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

材料 注記参照
MATERIAL SEE NOTES

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

仕上げ FINISH —

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

適用電線範囲 WIRE RANGE —

TITLE 名称

被覆外径 INS. RANGE —

0.8 B+B Conn Wafer Assy
ST SMT Without Boss
Embstp Pkg

DRAWN BY '93/1/28 T.ITO

CHK'D BY '00/12/16 T.ITO

APP'D BY '00/12/16 M.FUKUSHIMA

尺度 SCALE —

角度 ANGLE	±3°	C	変更 (JC2001-0421)	K.K.	T.J.	'00/12/6
30°以上	+0.3	B	変更 (J40748)	T.A.	H.H.	'94/3/29
10°以上 30°未満	-0.25	A	変更 (J30653)	TI	ST	'93/6/30
10°未満	±0.2	O	新規作成 PROPOSED (J30088)	TI	ST	'93/1/28
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-OIC(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-53364-**-91

E

D

C

B

A

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

F

E

D

C

B

A

5949932A.S03

8

7

6

5

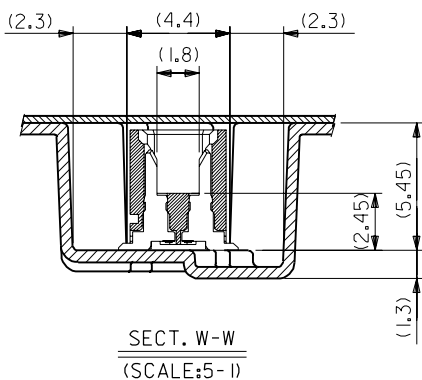
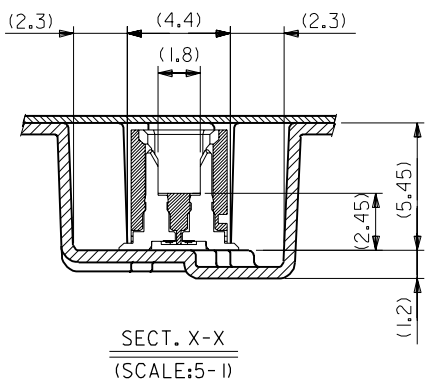
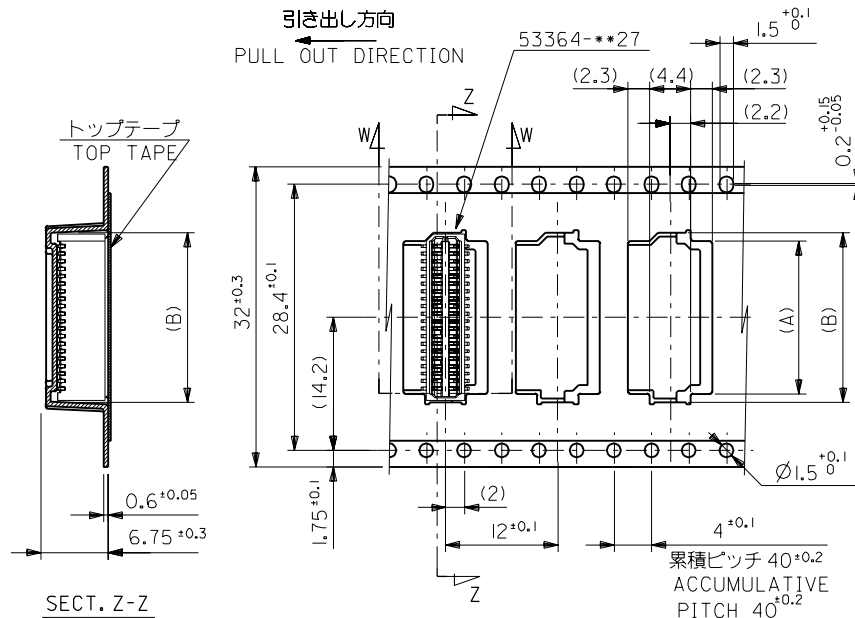
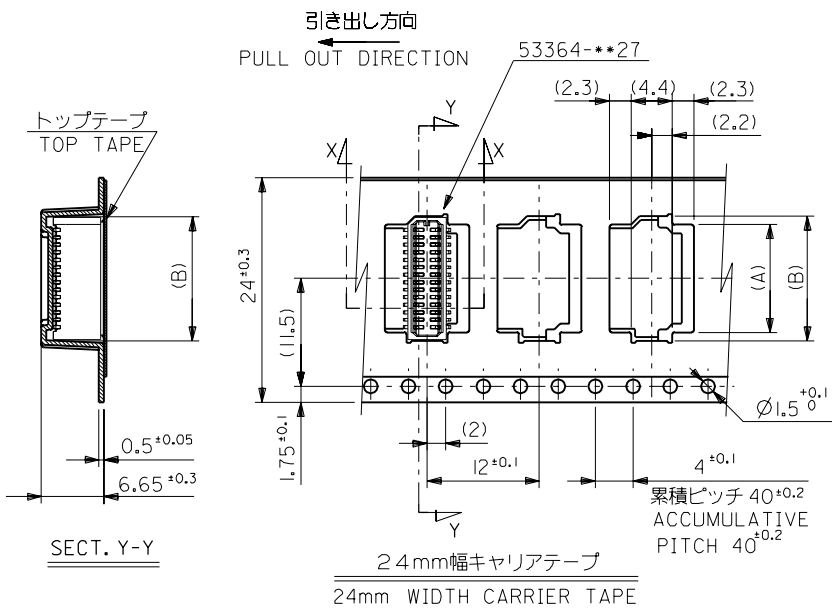
4

3

2

1

DWG. NO. SD-53364-**-91



32	33.5	18.9	17.1	53364-4291	42
		18.1	16.3	53364-4091	40
24	25.5	16.5	14.7	53364-3691	36
		14.1	12.3	53364-3091	30
		13.3	11.5	53364-2891	28
		10.1	8.3	53364-2091	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL	参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	材料 MOLLEX	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称 0.8 B+B Conn Wafer Assy ST SMT Without Boss Embstp Pkg	
被覆外径 INS. RANGE	—	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53364-**-91 C	
DRAWN BY '93/1/28 T.ITO	CHK'D BY '00/12/6 T.ITO	尺度 SCALE	—

角度 ANGLE	±3°	C	変更 REVISED (JC2001-0421)	K-K	T-I	'00/12/6
30以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISED (J40748)	T-A	H-H	94/3/29
10以上 30 UNDER	+0.25	A	変更 REVISED (J30653)	TI	ST	93/6/30
未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED (J30088)	TI	ST	93/1/28
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHR.	日付 DATE	APP'D BY '00/12/6 M.FUKUSHIMA

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

5949932A.S04